

公司代码：688047

公司简称：龙芯中科

**龙芯中科技股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn>/网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

详见 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案已经董事会审议通过，尚需股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙芯中科	688047	无

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓钰	李琳
联系地址	北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼	北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼
电话	010-62546668	010-62546668
传真	010-62600826	010-62600826
电子信箱	ir@loongson.cn	ir@loongson.cn

### 2、报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要通过向客户销售处理器及配套芯片与提供基础软硬件解决方案获取业务收入。为扩大龙架构的生态，公司将龙芯 CPU 核心 IP 开放授权给部分合作伙伴，支持合作伙伴研制基于龙架构指令系统及龙芯 CPU 核心 IP 的芯片产品。为支持芯片销售及应用，公司开发了基础版操作系统及二进制翻译系统等重要基础软件，并持续优化改进。

目前，龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能源、交通、教育等行业领域已获得广泛应用。

##### (1) 处理器及配套芯片产品

公司研制的芯片包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。报告期内，公司研制成功的新产品主要包括面向工控和终端等领域的 2K3000/3B6000M 通用 SoC 芯片（2K3000 和 3B6000M 是基于相同硅片的不同封装版本，分别面向工控领域和终端领域）、面向打印机领域的 2P0300 主控 SoC 芯片。

主要芯片产品型号如下：

### 1) 工控类芯片（龙芯1号、龙芯2号）

**龙芯 1C102** 是一款嵌入式领域定制的芯片产品，主要面向智能家居以及其他物联网设备，采用龙芯 LA132 处理器核心，该芯片集成 Flash、SPI、UART、I2C、RTC、TSENSOR、VPWM、ADC、GPIO 等功能模块，在满足低功耗要求的同时，大幅减少板级成本，具有高稳定、高安全、低成本等特点。产品主要应用于智能门锁类产品、电动助力车、跑步机等场景。

**龙芯 1C103** 集成 Flash、ATIM、GTIM、ADC、SPI、I2C、UART、RTC 等功能模块，可输出带有死区的互补 PWM 信号，具备驱动舵机、有刷电机、无刷电机的原生支持，同时具备常见的通讯模块。产品主要应用于高性价比的常见电机应用场景，如筋膜枪、修枝机、电锯等。

**龙芯 1C203** 是龙芯 1C103 的升级版，主要面向电机控制领域，片上集成 FPU、Flash、TIM、ADC、SPI、I2C、UART、CAN-FD 等功能模块，SRAM 取指主频相比前代提升 5 倍以上，具备驱动舵机、有刷电机、无刷电机的原生 PWM 控制信号支持。产品主要应用于高性价比、高算力要求的高速电机控制场景，如高速吹风机、洗车枪、电链锯等。

**龙芯 1D100** 是一款超声波水表、热表和气表测量专用 MCU 芯片，集成 CPU、Flash、时间测量单元（TDC）、超声波脉冲发生器、温度测量单元（THSENS）、SPI、I2C、UART、MBUS、段式 LCD 控制器、ADC、RTC、空管检测、断线检测等功能模块。产品主要应用于超声波水表、热表和气表测量专用场景。

**龙芯 2K0500** 是一款 64 位单核 SoC 芯片，主频 500MHz，基于 LA264 处理器核，集成 DDR3、2D GPU、DVO、PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、USB3.0、GMAC、PCI、彩色黑白打印接口、HDA 及其他常用接口。产品主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC 等应用场景。

**龙芯 2K1000LA** 是一款 64 位双核 SoC 芯片，主频 1.0GHz，基于 LA264 处理器核，集成 DDR2/3、PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、DVO 等接口。产品主要应用于交换机、边缘网关、工业防火墙、工业平板、智能变电站、挂号自助机等场景。

**龙芯 2K1500** 是一款 64 位双核 SoC 芯片，主频 1.0GHz，基于 LA264 处理器核，集成 DDR3、PCIe3.0、SATA3.0、USB2.0 接口，提供数量丰富的 SPI、CAN、I2C、PWM 等小接口，支持 eMMC 功能。产品主要用于满足低功耗场景下的工控需求。

**龙芯 2K2000** 是一款通用 64 位双核 SoC 芯片，典型工作频率 1.4GHz，基于 LA364 处理器核，集成龙芯自主研发的 3D GPU 核，集成了 DDR4-2400、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、HDMI 及 DVO、GNET 及 GMAC、音频接口、SDIO 及 eMMC、CAN 等丰富的接口，同时还集成了安全可信模块，产品可满足多场景工控互联网应用需求。

**龙芯 2K0300** 是一款多功能 64 位单核 SoC 芯片，主频 1.0GHz，基于 LA264 处理器核，集成 16 位 DDR4 访存接口，并集成丰富的外设接口，包括 USB2.0、GMAC、LCD 显示、I2S 音频、高速 SPI/QSPI、ADC、eMMC、SDIO 和其它工控领域常用接口，具有低功耗、高能效比的特点。产品主要应用于工业控制、通信设备、信息家电和物联网等领域。

**龙芯 2K3000** 是一款面向工控应用的通用 64 位八核 SoC 芯片，内置 8 个 LA364E 处理器核心，集成提供图形计算和 AI 计算的龙芯自研 LG200 GPGPU 核、多格式支持的媒体编解码模块、提供安全启动和密码服务的龙芯自研 SPU 模块，支持 DDR4/LPDDR4、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、DP/eDP/HDMI、GMAC、HDA/I2S、SDIO/eMMC 等众多外设接口，支持 RapidIO、CAN 和 TSN 等工业接口。

**龙芯 2P0500** 是一款适用于单/多功能打印机的主控 SoC 芯片，是打印/扫描整机中核心控制部件，内置龙芯 LA364、LA132 处理器核以及 512KB 共享二级缓存，集成 DDR3、GMAC、USB、打印接口、扫描接口、eMMC、PWM 等多种功能模块，并实现功耗管理控制模块。单芯片可满足打印、扫描、复印等多种典型应用需求。

**龙芯 2P0300** 是一款适用于单/多功能打印机的主控 SoC 芯片，内置龙芯 LA264、LA132 处理器核以及 256KB 共享二级缓存，集成 DDR3/4、GMAC、USB/OTG、打印接口、扫描接口、SDIO/eMMC

等多种接口模块，支持低功耗控制。

## 2) 信息化类、工控类芯片（龙芯 3 号）

**龙芯 3A5000** 是面向个人计算机、服务器等信息化领域的 64 位 4 核通用处理器，主频 2.3-2.5GHz，集成 4 个 LA464 处理器核，集成双通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口。产品主要应用于桌面与终端类应用。

**龙芯 3A6000** 是龙芯第四代微架构首款处理器，是 64 位 4 核处理器，主频 2.0-2.5GHz，集成 4 个 LA664 处理器核，支持同步多线程技术，集成双通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口。面向高端嵌入式计算机、桌面等应用。

**龙芯 3C5000** 是一款面向服务器市场的 64 位 16 核处理器，主频 2.0-2.2GHz，集成 16 个高性能 LA464 处理器核，集成四通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口，最高支持十六路互连。片内还集成了安全可信模块。

**龙芯 3D5000** 是一款面向服务器市场的 64 位 32 核处理器，主频 2.0GHz，由两个 3C5000 硅片封装在一起，集成 32 个 LA464 处理器核，集成八通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口，单机系统最高可支持四路互连 128 核。片内还集成了安全可信模块。

**龙芯 3C6000/S** 是一款面向服务器市场的 64 位 16 核 32 线程处理器，主频 2.2GHz，集成 16 个高性能 LA664 处理器核，集成四通道 DDR4-3200 和 PCIe 接口，单机系统最高支持双路互连 32 核 64 线程。片内还集成了安全可信模块。

**龙芯 3C6000/D (3D6000)** 是一款面向服务器市场的 64 位 32 核 64 线程处理器，主频 2.1GHz，由两个 3C6000 硅片封装在一起，集成 32 个高性能 LA664 处理器核，集成八通道 DDR4-3200 和 PCIe 接口，单机系统最高支持四路互连 128 核 256 线程。片内还集成了安全可信模块。

**龙芯 3C6000/Q (3E6000)** 是一款面向服务器市场的 64 位 64 核 128 线程处理器，主频 2.0GHz，由四个 3C6000 硅片封装在一起，集成 64 个高性能 LA664 处理器核，集成八通道 DDR4-3200 和 PCIe 接口，单机系统最高支持双路互连 128 核 256 线程。片内还集成了安全可信模块。

**龙芯 3B6000M** 是一款面向终端应用的通用 64 位八核 SoC 芯片，内置 8 个 LA364E 处理器核心，集成提供图形计算和 AI 计算的龙芯自研 LG200 GPGPU 核、多格式支持的媒体编解码模块、提供安全启动和密码服务的龙芯自研 SPU 模块，支持 DDR4/LPDDR4、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、DP/eDP/HDMI、GMAC、HDA/I2S、SDIO/eMMC 等众多外设接口，支持 RapidIO、CAN 和 TSN 等工业接口。

## 3) 配套芯片

**龙芯 7A1000** 是面向服务器及个人计算机领域的龙芯 3 号系列处理器的配套桥片，通过 HT3.0 接口与处理器相连，外围接口包括 PCIe2.0、GMAC、SATA2.0、USB2.0 和其他低速接口。可以满足部分服务器及个人计算机领域应用需求，并为其扩展应用提供相应的接口。

**龙芯 7A2000** 是面向服务器及个人计算机领域的第二代龙芯 3 号系列处理器配套桥片，通过 HT3.0 接口与处理器相连。外围接口包括 PCIe3.0、USB3.0、SATA3.0；显示接口为 2 路 HDMI 和 1 路 VGA，可直连显示器；内置一个网络 PHY，直接提供网络端口输出；片内集成自研 3D GPU，采用统一渲染架构，搭配 32 位 DDR4 显存接口，最大支持 16GB 显存容量。

**其他配套芯片**包括 LDO 电源芯片、DCDC 电源芯片、时钟芯片等，主要用于与龙芯系列处理器芯片配套使用。

### (2) 解决方案

公司基于开放的龙架构生态体系，与板卡、整机厂商及基础软件、应用解决方案开发商建立紧密的合作关系，为下游企业提供基于龙芯处理器的各类开发板及软硬件模块，并提供完善的技

术支持与服务。

报告期内，公司依靠龙芯新一代芯片高性价比优势积极拓展工控和开放市场，着力提升服务器主板 ODM 能力，强化包括 CPU、操作系统、主板在内的“三位一体”能力。在信息化应用领域继续结合特定应用需求，基于 3A5000、3A6000、3B6000M、3C5000、3C6000 等系列芯片持续优化存储服务器、行业终端、国密云等解决方案，形成系统级性价比优势。在行业工控领域，基于 3A5000、2K3000、2K2000、2K1500、2K0300 等芯片，积极拓展安全应用、能源、交通、制造等领域，深化龙架构工业生态建设工作，研发不同规格、功耗、应用场景的开发板或核心模块，形成场景级解决方案。在开放市场，充分发挥 2P0500、2P0300、1D0100、1C203 低成本优势，优化水表、打印机应用，开发电机驱动解决方案。通过解决方案带动芯片销售，显示出较好的市场前景。

报告期内，公司主营业务基本未发生变化。

## 2.2 主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司主要采用 Fabless 模式，设计形成集成电路版图后，将晶圆制造和部分封测等环节委托给相关制造企业及代工厂商加工完成。为了加速研发迭代、提高产品品质、有效保障供给，公司建立了测试车间，具备与业务需求相匹配的筛选测试能力。

公司主要通过向客户销售处理器及配套芯片与提供基础软硬件解决方案获取业务收入。为加速龙架构的生态建设，公司有序开展龙架构及核心 IP 授权业务，支持合作伙伴研制基于龙架构指令系统及龙芯 CPU 核心 IP 的芯片产品。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路设计行业位于集成电路产业链的上游，是典型的技术密集型产业，对技术研发能力要求极高，具有高技术门槛、高产品附加值以及众多细分门类的特点。集成电路设计的能力直接体现了国家在该领域的实力与地位。

作为全球最大的集成电路市场之一，中国的市场规模持续增长。这不仅受益于消费电子、汽车电子、人工智能等应用领域的蓬勃发展，还得益于中国企业不断增加的技术创新投入和自主创新能力的快速提升。中国集成电路产业的快速发展引起了美西方的高度关注，并促使它们采取了一系列打压措施，给中国带来了严峻挑战。然而，这也加速了中国的自主创新进程和国产替代的步伐。在国家政策的大力支持和持续加码下，中国在集成电路的设计、制造、封装测试等环节均取得了显著进步。在制造方面，中国在成熟制程领域取得显著进展，并逐步迈向更先进的节点；在封装测试环节，掌握了复杂基板制造技术，并开始向高端迈进；在设计领域，国产芯片呈现出百花齐放的局面，自给率大幅提升，性能上也日益接近国际先进水平，其中最具代表性的就是 CPU。

CPU 作为信息产业中最基础的核心组件，承担着计算机的运算与控制核心的角色，对通用计算处理能力等性能指标有着极高的要求，被视为集成电路设计中的最高端产品。CPU 设计需要深厚的知识积累和精湛的技术水平，掌握其核心技术需要长时间的研发投入和持续迭代。即使引进国外的 CPU IP 核，缺乏足够的工程实践和技术积累，也难以实现真正的消化吸收。因此，CPU 的技术储备需要较长的时间周期。

鉴于 CPU 设计的技术门槛高、研发周期长，并且存在极高的生态壁垒，X86 体系目前在桌面和服务器市场上占据主导地位，而 ARM 架构则主要应用于移动平台，在移动芯片市场中占主导地位。在中国，大多数 CPU 产品基于 X86 和 ARM 指令系统。近年来，建立独立于 X86 和 ARM 之外的第三套生态系统已成为业界共识，一方面是为了应对美西方的技术封锁，另一方面得益于国内处理器设计和基础软件研发水平的提高。在此背景下，LoongArch、RISC-V 等新兴指令系统迅速崛起，其中 RISC-V 因其开源、免费、可扩展等特性，在物联网和边缘计算等领域展现了巨大潜力。

与此同时，LoongArch 凭借其自主性、先进性和兼容性，在服务器、终端、工控等多个领域得到广泛应用，随着 LoongArch 软件生态系统的不断完善，中国自主的第三套生态系统正在不断壮大。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

“龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一。通过长期积累，公司已拥有一系列自主专利和知识产权，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内通用处理器行业的领先地位。

公司坚持建立独立于 X86 体系和 ARM 体系的安全可控的信息技术体系和产业生态，坚持自主研发，推出了自主指令系统龙架构，掌握 CPU IP 核的所有源代码，拥有操作系统和基础软件的核心能力，持续研发及优化包括 CPU IP 核、GPU IP 核、接口 IP 核等在内的多个自主软/硬 IP 核，不依赖国外技术授权（包括指令系统、IP 核等），不依赖境外供应链，从基于自主 IP 的芯片研发、基于自主工艺的芯片生产、基于自主指令系统的软件生态三个环节提高自主可控度，保障供应链安全的同时基于自主技术构建自主体系和生态。

完成龙芯“三剑客”“三尖兵”芯片产品化工作并推向市场，在竞争中体现出性价比优势。充分发挥龙芯自主化的优势，基于 LA 指令系统开展技术授权，拓展市场空间，完善龙架构软件生态，形成新的可持续销售收入。

与指令系统相关的主要开源基础软件社区都在版本演进中继续以较高级别和较完善的程度实现对龙架构的常态化支持。开源软件世界有着重要影响力的 Debian 操作系统社区在 2025 年底正式宣布支持龙架构，体现了主流开源操作系统社区对龙架构开源基础软件生态完备度与成熟度的检验与认可，标志着龙架构的开源基础软件生态已进入“依托社区、协同开发、稳定演进”的阶段。基于开源鸿蒙社区最新版本，持续完善和优化龙架构的开源鸿蒙操作系统。研制发布了 Linux、开源鸿蒙、嵌入式三类操作系统的 LG200 系列 GPGPU 驱动，实现了对主流图形编程标准的支持。研制了支持算力芯片的龙芯加速计算环境，完成了对主要推理框架和常用模型的支持。研制了浏览器兼容解决方案，实现了对各类插件和外设的支持，基本解决主要业务领域存量网页应用的兼容问题。研制了外设驱动引擎，实现了对打印机、扫描仪、高拍仪等设备驱动的支持，系统解决 Linux 生态的外设驱动问题。龙架构软件生态壁垒得到实质性破解。

龙芯基于自主研发构建自主生态的理念越来越得到产业主管部门、产业链合作伙伴和用户的认同。

## (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从技术和产业发展趋势看，信息产业的基础软硬件平台趋于成熟，应用创新方兴未艾，硅平台成为应用创新的重要平台。信息产业的创新从传统 CPU 和操作系统创新转向包括云计算、大数据、人工智能、物联网等在内的应用创新。一是打通硬件、软件与应用，通过系统优化提升性能，以 Intel、AMD 为代表的平台型企业不断向配套芯片扩展，如 Intel 的独立显卡、AMD 的 AI 加速卡等，形成面向 AI 大模型、终端等应用的系统解决方案，而以谷歌、苹果、阿里、华为为代表的系统企业也在研制专用芯片，针对大语言模型等应用形成全链条解决方案，信息产业的商业模式从横向模式转向纵横结合的模式；二是信息产业的发展由以摩尔定律为代表的技术驱动转向以云计算、大数据、人工智能为代表的拉动，把过去需要在操作系统之上用软件实现的算法直接在硅平台上由硬件实现，形成包括 GPU、NPU 等在内的各种专用加速器；三是先进制程工艺仍在演进但边际效应降低，以 2.5D/3D IC 为代表的高端封装成为提高性能的新的创新平台。

从芯片制造端看，2025 年总体上全球半导体市场在 AI 和地缘政治需求的带动下持续增长，集成电路先进制造工艺取得持续突破，高端工艺产能不断提升。境内企业正在努力克服国际政治与经济形势影响，不断提升集成电路产线的自主可控度，尽管和国际最先进逻辑工艺的代差依然明显，但境内工艺的先进性和产能提升都取得了积极进展，可以基本满足我国集成电路多数场景

下的工艺需求。先进封装工艺平台方面，境内企业 BGA 封装产能持续扩大，基板等重要原材料自主性明显提升，2.5D/3D 封装持续投入。

从芯片设计端看，随着地缘政治冲突的持续加剧，美西方对我国高端设计企业不断打压。一方面，试图通过供应链制裁以及对架构、高端 IP 授权等方面进行技术封锁，限制企业向高端发展；另一方面，试图通过放开部分“高端”芯片冲击境内尚在成长的自主研发能力。在此前提下，国内集成电路产业也更加认同通过自主创新解决“卡脖子”问题。党的二十届四中全会关于十五五规划的建议指出“全链条推进集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，构建自主可控的信息技术体系和产业生态已经成为行业共识并正在取得积极进展。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	316,187.09	349,748.34	-9.60	411,208.9
归属于上市公司股东的净资产	250,658.31	293,639.71	-14.64	354,892.49
营业收入	63,532.06	50,425.72	25.99	50,569.44
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	63,532.06	50,419.97	26.01	50,462.67
利润总额	-44,528.46	-66,528.28	不适用	-38,351.29
归属于上市公司股东的净利润	-45,514.03	-62,534.71	不适用	-32,943.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,826.76	-66,472.53	不适用	-44,186.01
经营活动产生的现金流量净额	-34,789.27	-33,501.01	不适用	-41,032.74
加权平均净资产收益率(%)	-16.73	-19.29	增加2.56个百分点	-8.84
基本每股收益(元/股)	-1.14	-1.56	不适用	-0.82
稀释每股收益(元/股)	-1.14	-1.56	不适用	-0.82
研发投入占营业收入的比例(%)	79.75	105.34	减少25.59个百分点	103.47

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	12,495.54	11,855.75	10,718.05	28,462.72

归属于上市公司股东的净利润	-15,128.04	-14,318.78	-9,934.44	-6,132.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,712.08	-16,256.06	-11,178.04	-7,680.58
经营活动产生的现金流量净额	-14,359.42	-17,920.30	-12,383.45	9,873.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4、股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		23,613					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		35,887					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
北京天童芯源科技有限公司		86,468,978	21.56		无		境内非 国有法 人
北京中科算源资产管理有限公司		77,477,539	19.32		无		国有法 人
林芝鼎孚创业投资管理有限公司—宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-3,886,160	24,118,940	6.01		无		其他
北京工业发展投资管理有限公司	-3,583,754	22,242,092	5.55		无		国有法 人

利河伯资本管理（横琴）有限公司—横琴利禾博股权投资基金（有限合伙）	-2,504,022	15,540,878	3.88		无		其他
北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）	-2,261,112	10,651,811	2.66		无		其他
北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）	-2,453,967	10,458,956	2.61		无		其他
北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）	-783,140	8,055,448	2.01		无		其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-2,857,652	7,808,864	1.95		无		其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	608,140	7,319,100	1.83		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人胡伟武和晋红为天童芯源、芯源投资、天童芯正及天童芯国的实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 存托凭证持有人情况

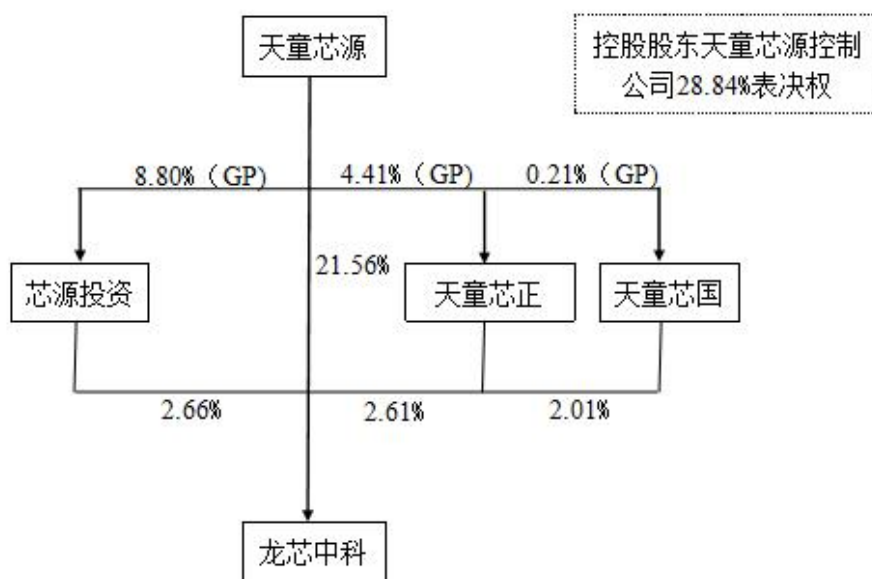
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

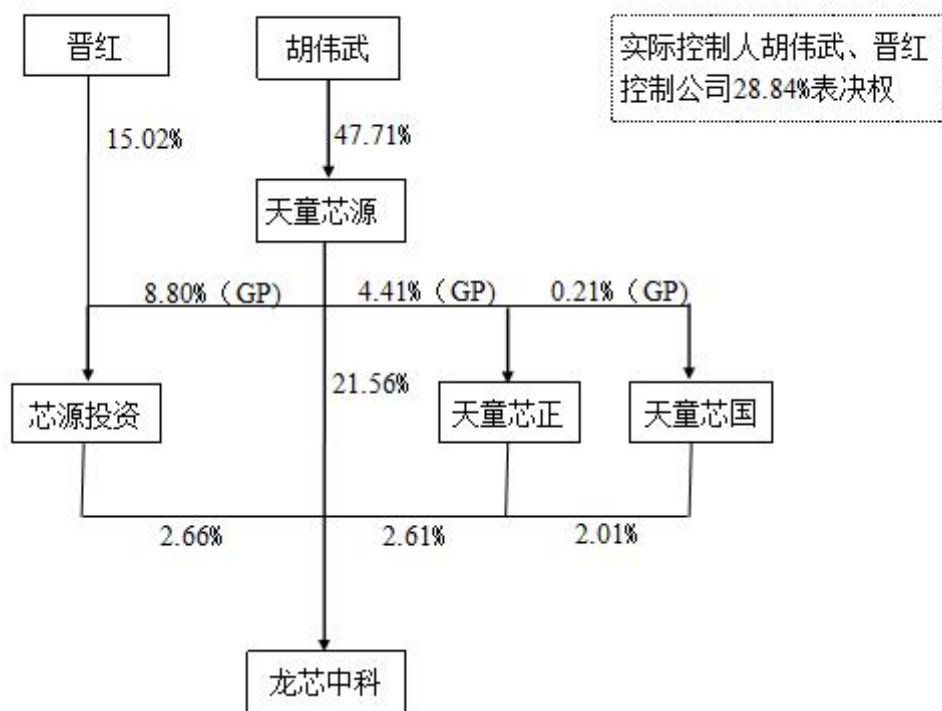
适用 不适用



注：部分员工于 2025 年 8 月通过员工持股平台芯源投资、天童芯正和天童芯国实施询价转让方式减持，故天童芯源在芯源投资、天童芯正和天童芯国的权益比例被动提高至 10.67%、5.44% 和 0.23%。

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



注：部分员工于 2025 年 8 月通过员工持股平台芯源投资、天童芯正和天童芯国实施询价转让方式减持，故天童芯源在芯源投资、天童芯正和天童芯国的权益比例被动提高至 10.67%、5.44%

和 0.23%，晋红在芯源投资的实际权益比例降至 14.57%；胡伟武未参与上述减持，故其通过天童芯源和上述员工持股平台对公司的间接持股数未因为上述减持事宜发生变化。

天童芯源于 2025 年 12 月实施了内部股东股权转让，胡伟武在天童芯源的持股比例从 47.67% 提高至 47.71%。

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参考 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用